



证券代码：300567 证券简称：精测电子 编号：2026-008

武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他_____
参与单位名称及人员姓名	银华基金徐波、李晓星、于蕾、方建、和玮、张腾、薄官辉、王利刚、施航、张舰、吴颖、范昭楠、倪明、郭磊、方新一、唐泽辉、陈子浩；新华资产兰宏阳、吕江禹、何晨宇、李丕、李政兴；国泰海通高瑞、陈筱；人保资产周修启、肖迪；泰康资产陈臻迪、魏博等 31 余人（排名不分先后）
时间	2026 年 10 月 15 日-16 日
地点	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：刘炳华先生 证券事务代表：程敏女士
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：公司在半导体领域发展情况如何？ A：公司紧抓半导体设备国产化替代的关键窗口期，持续巩固并提升在半导体量检测领域的国内领先地位，进一步加大对先进制程领域（28nm 以下）的研发投入与产品布局，公司明场缺陷检测、无图形暗场缺陷检测设备等新产品研发及产业化取得显著进展。伴随产品迭代优化，设备整机成熟度持续提升，供应链核心零部件实现进一步完善与稳定；公司新取得头部客户明场缺陷检测 14nm 工艺节点相关订单，标志着该类产品在先进制程领域的市场应用实现进一步突破，为后续先进制程设备的业务拓展奠定基础。随着前期高强度研发投入逐步进入业绩兑现阶段，公司技术产业化进程全面提速，半导体领域主营产品均实现规模化



量产，交付能力大幅增强。与此同时，公司持续优化业务结构、提升经营效率，推动半导体板块盈利能力显著改善，新签订单相较去年同期实现大幅增长。

截至《2026 年半年度报告》披露日，公司取得在手订单金额总计约 55.89 亿元，较上年同期增长 54.89%；其中，半导体领域在手订单约 36.09 亿元，较上年同期增长 98.00%；显示领域在手订单约 12.28 亿元，较上年同期减少 14.68%；新能源领域在手订单约 7.52 亿元，较上年同期增长 117.22%。半导体领域在手订单占公司订单比例已近七成，半导体业务已成为公司经营业绩的核心支撑。

Q2：公司明场光学缺陷检测设备进展情况。

A：公司在明场光学缺陷检测领域，面向先进逻辑、存储制程的有图形晶圆缺陷检测设备，提供高灵敏度、高分辨率、高检测效率和非破坏性的缺陷检测。最新进展方面，产品已完成 28nm 制程产线的验收和 14nm 制程产线的交付；2026 年上半年，公司新取得国内头部客户 14nm 制程订单，目前该设备已完成交付，伴随着公司 14nm 制程订单的再一次交付，产品迭代优化，设备整机成熟度持续提升，供应链核心零部件实现进一步完善与稳定，上述进展进一步巩固了公司在明场光学缺陷检测设备领域的领先优势，有利于带动国内该类装备的技术迭代与产业发展。

Q3：公司 HBM 相关前道量检测设备类型和业务介绍。

A：在 HBM 先进封装前道量检测领域，公司现有膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备、明场光学缺陷检测设备为核心产品已全部导入先进封装产线。公司先进封装业务主要跟随客户的开发节奏同步推进，现阶段，公司面向 2.5D 和 3D 先进封装的设备主要有 TSV 刻蚀后高深宽比结构测量、HBM 硅片形貌测量、混合键合表面粗糙度测量、TSV 填铜后 CMP 集成式铜凹陷量测等设备，多款设备已完成客户交付，实现落地应用。

Q4：公司在 TGV 领域的进展和布局介绍。



A：公司围绕玻璃基板及面板级先进封装已形成专项产品布局，相关设备已累计交付多台。其中 TGV 相关方案已覆盖孔径、位置度、上下表面孔径、腰孔、真圆度、锥度及孔内结构等关键量检测项目，目前已具备相关关键参数亚微米至微米级量测能力，并已与多家客户完成样品打样及检测验证。公司正结合不同客户的材料、孔型及工艺需求，持续推进设备优化和产品定型。

后续，公司将结合下游客户工艺成熟度和产线建设节奏，持续推进 TGV 相关设备的工艺验证、产品定型及量产适配，重点提升大尺寸面板、高精度量测、多层结构检测及量产效率等能力，积极把握玻璃基板及面板级先进封装国产化发展机遇。

Q5：公司在半导体后道电测检测领域情况介绍。

A：公司聚焦 ATE 领域持续深耕，构建起覆盖先进存储和 SOC（系统级芯片）全场景测试体系，为不同领域客户提供定制化、高效可靠的系统测试解决方案。面向先进存储芯片，可提供集成 BI（Burn-In）测试、CP（Chip Probing）测试和 FT（Final Test）测试于一体的多场景测试方案，全面支持最新的 DDR5/LPDDR5/NANDFLASH/UFS 等多种存储器芯片。其中，公司应用于 UFS 产品的 FT 设备技术水平处于国内领先地位，已取得国内头部客户批量订单。同时针对 AI 领域的高带宽存储（HBM），推出 JH5520 HBM BI 测试系统，精准满足高端存储测试需求。面向系统级芯片，覆盖 50W~1000W 功率级别的芯片功能、性能及可靠性的测试。

Q6：请问公司各类产品的核心零部件国产化率有多少？

A：公司核心零部件及所需国产软件绝大部分已实现自主研发和生产。公司始终重视半导体领域核心部件的国产化进程，持续关注并努力提升保障核心供应链安全和稳定的能力，后续公司将继续加强与国内供应商的合作，进一步提高国产品牌在供应链中的占比。

Q7：公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套



	资金事项进展介绍。 A：公司已于 2026 年 7 月 16 日披露重大资产重组预案，拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买上海精测剩余 41.17%股权并配套募资。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，目前本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司会严格按照信息披露的规定和要求及时披露后续进展。本次交易完成后，上海精测将成为公司全资子公司，有利于进一步提高公司资产质量、增强业务上的协同性，公司持续经营能力和核心竞争力将得以进一步提升，并促进公司业务进一步聚焦半导体领域。 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 16 日